

SOIPIX Sensor を用いたチップ積層 **3D** プロセス プ
ロセス解説と現状の課題・対応

Friday, 20 December 2024 09:30 (20 minutes)

Presenter: 倉知郁生 (株) ディーアンドエス

Session Classification: デバイス構造, 回路設計等